

製品実装後に半田付けの確認が可能、独自技術で高い実装信頼性を確保
Original Technology Provides High Mounting Reliability by Enabling Solder Verification After Mounting

NEW

ROHM
SEMICONDUCTOR

超小型 低オン抵抗 Wettable Flank MOSFET

Ultra-Compact Low ON Resistance Wettable Flank MOSFET

RV4xxx Series

Features

■ 小型高放熱かつ低オン抵抗

High heat dispersion and low on-resistance in a miniature package

■ Wettable Flankを採用することで安定した半田フィレット形成

Wettable flank design ensures stable solder fillet formation

■ 製品実装後に半田付けの確認が可能
(DFN1010-3W / 1212-3W > 125 μ m保証、
DFN1616-6W > 130 μ m保証)

The soldering can be checked after mounting
(DFN1010-3W / 1212-3W > 125 μ m,
DFN1616-6W > 130 μ m)

■ 豊富なパッケージ展開

Broad package lineup

■ AEC-Q101対応

AEC-Q101 qualified

Applications

■ 車載機器

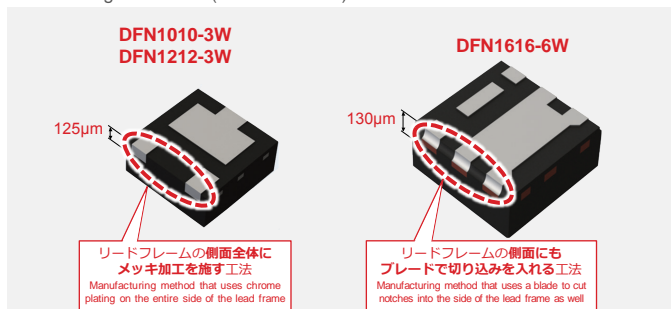
Automotive systems

■ 産業機器

Industrial equipment

DFNパッケージの構造 (Wettable Flank)

DFN Package Structure (Wettable Flank)

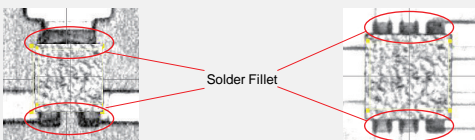


外観検査時の判定結果

External Visual Inspection Results

DFN1010-3W
DFN1212-3W

DFN1616-6W



はんだフィレットの高さを十分に確保することで、
実装後にはんだ付けの確認が可能

By ensuring that the solder fillet is sufficiently high, the soldering can be checked after mounting

小型高放熱かつ低オン抵抗を実現

High heat dispersion and low on-resistance in a miniature package

Conventional Leaded Type
(2.4mm x 2.9mm)

68%
Smaller Size

New DFN Package
(1.6mm x 1.6mm)

	Conventional Leaded Type	New DFN Package
P _o	200mW	7.5倍 → 1500mW
R _{os(on)}	190m Ω	43%減 → 108m Ω

従来のリードタイプに対し、DFNタイプにすることで小型かつ大電流を実現
ROHM's new DFN type achieves greater miniaturization and larger current capability as conventional leaded types

ラインアップ

Lineup

	BV _{oss} (V)	Package		
		DFN1616-6W	DFN1212-3W	DFN1010-3W
P ch	-20	RV4C020ZP	-	-
	-30	RV4E031RP	-	-
	-60	-	RV6L009SP	B5S84X
N ch	20	-	-	RV8C010UN
	30	RV4E034UN	RV6E015UN	-
	60	RV4L016SN	RV6L013SN	RV8L002SN